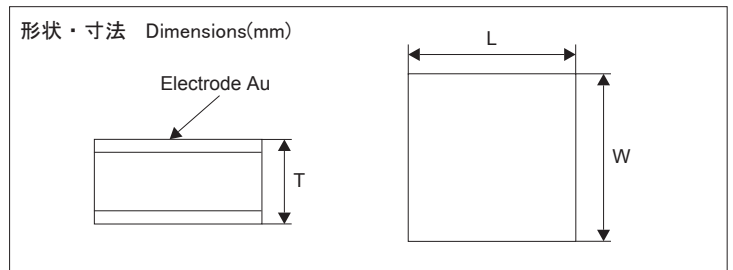
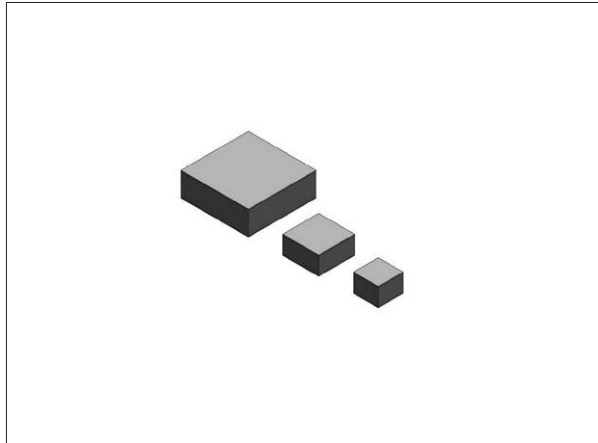


光通信・LEDモジュール用

For Optical Communications and LED Modules

FH/VH/LN シリーズ

FH/VH/LN



シリーズ名 Series	L	W	T
VH02	0.21±0.03	0.21±0.03	0.2 max
FH05, VH05	0.32±0.05	0.32±0.05	0.2 max
FH10	0.55 or 0.60±0.05	0.55 or 0.60±0.05	0.3 max
VH10, LN10	0.60±0.05	0.60±0.05	0.3 max

FH シリーズ

FH Series

■特長

- 小型で高精度である。
- 長期信頼性に優れている。
- はんだ濡れ性、ボンディング性に優れている。
- Au/Sn はんだ実装時の安定性に優れている (約 300°C)

■Features

- Small precision type
- Long-life Reliability
- Excellent solderability, bondability
- Excellent stability against Au/Sn soldering process (about 300°C)

■FH05 シリーズ FH05series

FH05 シリーズ (光通信モジュール用) FH05Series (Optical communication related equipment)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%) Resistance tolerance at 25°C				B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%) B value tolerance			抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
		±1	±2	±3		±1							
6D103*C	-40~+125°C	±1	±2	±3		±1			10kΩ	3,930K	3,941K	15	0.15

■FH10 シリーズ FH10series

FH10 シリーズ (光通信モジュール用) FH10Series (Optical communication related equipment)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%) Resistance tolerance at 25°C				B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%) B value tolerance			抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
		±1	±2	±3		±1							
6E103*C	-40~+125°C	±1	±2	±3		±1			10kΩ	3,950K	4,000K	30	0.3
6Q103*C		±1	±2	±3		±1			10kΩ	3,410K	3,455K		
3U104*C		±1	±2	±3		±1			100kΩ	3,950K	4,024K		

光通信・LEDモジュール用

For Optical Communications and LED Modules

VH シリーズ

VH series

■特長

- FHシリーズの特長を兼ね備え、さらに長期信頼性、高耐熱実装性（最高温度 350℃）に優れる。

■Features

- Building on the strengths of the FH series, it has even longer life accuracy and is capable of 350℃ (max) soldering.

■VH02 シリーズ VH02 series

VH02シリーズ(超高信頼性光通信モジュール用) VH02Series (Unparalleled Long-Term Accuracy Thermistors for Optical Communications Modules)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%) Resistance tolerance at 25°C			B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%) B value tolerance			抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
7J103HS	-40~+125°C			±3			±1	10kΩ	4,090K	4043K	(14)	(0.14)

■VH05 シリーズ VH05 series

VH05シリーズ(超高信頼性光通信モジュール用) VH05Series (Unparalleled Long-Term Accuracy Thermistors for Optical Communications Modules)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%) Resistance tolerance at 25°C			B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%) B value tolerance			抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
6D103*C	-40~+125°C	±1	±2	±3			±1	10kΩ	3,930K	3,941K	15	0.15

■VH10 シリーズ VH10 series

VH10シリーズ(超高信頼性光通信モジュール用) VH10Series (Unparalleled Long-Term Accuracy Thermistors for Optical Communications Modules)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%) Resistance tolerance at 25°C			B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%) B value tolerance			抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
6E103*C	-40~+125°C	±1	±2	±3			±1	10kΩ	3,950K	4,000K	30	0.3

LN シリーズ

LN series

■特長

- VHシリーズの特長を兼ね備えたLEDモジュール用

■Features

- Combining the strengths of the VH series and optimized for LED modules.

■LN10 シリーズ LN10 series

LN10シリーズ(超高信頼性LEDモジュール用) LN10 Series (Unparalleled Long-Term Accuracy Thermistors for LED Modules)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%) Resistance tolerance at 25°C			B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%) B value tolerance			抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
9X101JC	-40~+125°C			±5			±3	100Ω	3,110K	4,000K	30	0.3

■推奨はんだ条件

FH、VH、LN シリーズ Au/Sn はんだ実装
はんだ：Au/Sn (79/21) プリフォーム
実装装置：ダイボンダー
N₂ 流量：3L/min
実装温度：320℃

- 1) 280℃を超える温度は 10 秒以内として下さい。
- 2) はんだ付け後は、急冷を避け、徐冷して下さい。
- 3) スクラブ条件については、別途ご相談下さい。

■Recommended Soldering Profile

FH、VH、LN Series Au/Sn Solder mounting
Solder : Au/Sn (79/21)Preform
Mounting device : Die bonder
N₂ flow : 3L/min
Mounting Temperature : 320℃

- 1) Please keep exposure to temperature exceeding 280℃ to under 10seconds.
- 2) After soldering, do not force cool, allow the parts to cool gradually.
- 3) Please contact us about scrubbing procedures.